

TM-650 INDEX

TM ナンバー	ページ 番号	題目
セクション 1.0 - レポートと測定の分析法		
TM 1.1C	1	初めに - 1/03
TM 1.2A	2	校正 - 1/03
TM 1.3A	3	環境条件 - 1/03
TM 1.4A	4	レポート、全般 - 1/03
TM 1.5A	5	レポート、形式 - 1/03
TM 1.6A	7	数値レポート - 1/03
TM 1.7A	8	レポート、無効な試験結果 - 1/03
TM 1.8A	9	バイナリデータ向け測定精度の推定 - 1/03 (計算機とユーザーガイド含む)
TM 1.9A	15	変数データ向け測定精度の推定 - 1/03 (計算機とユーザーガイド含む)
セクション 2.1 - 目視試験の方法		
TM 2.1.1.1	25	マイクロセクションング、セラミック基板 - 12/87
TM 2.1.1.2A	27	マイクロセクションング?半自動式または自動式技術マイクロセクションング装置 (オルタネート) - 5/04
TM 2.1.2A	31	ピンホール評価、染料浸透法 - 3/76
TM 2.1.3A	32	メッキ - スルーホール 構造評価 - 8/76
TM 2.1.5A	33	表面試験、アングラッドとメタルクラッド材 - 12/82
TM 2.1.6B	34	ガラス繊維の厚み - 12/94
TM 2.1.6.1	35	繊維補強の重量 - 12/94 (2.3.12より番号を再割り当て)
TM 2.1.7C	36	ガラス繊維のスレッドカウント - 12/94
TM 2.1.7.1	37	スレッドカウント、有機繊維 - 12/87
TM 2.1.8B	38	仕上がり - 12/94
TM 2.1.9	39	表面引っかき傷試験 メタルクラッドフォイル - 5/86
TM 2.1.1E	40	マイクロセクションング、手動 - 5/04
TM 2.1.10A	45	不溶解ジシアンジアミドの目視検査 - 12/94
TM 2.1.13B	48	フレキシブルプリント基板材のポイド検査 - 5/12
セクション 2.2 - 寸法検査法		
TM 2.2.1A	49	メカニカル寸法検証 - 8/97
TM 2.2.2B	50	オプティカル寸法検証 - 8/97
TM 2.2.4C	51	寸法安定性、フレキシブル誘導体材料 - 5/98
TM 2.2.5A	53	マイクロセクションングを利用した寸法検査 - 8/97
TM 2.2.6A	54	穴寸法測定、ドリル穴 - 8/97
TM 2.2.7A	55	穴寸法測定、メッキ - 5/86
TM 2.2.8	56	穴位置 - 4/73
TM 2.2.10A	57	穴位置と 導体位置 - 12/83
TM 2.2.12A	58	同厚み、重量別 - 3/76
TM 2.2.12.1	59	処置済・未処置銅はくの全厚と形状要素 - 9/87
TM 2.2.12.2	61	開放可能キャリアつき銅はくの重量と厚み - 7/89
TM 2.2.12.3	62	エッチング可能キャリアつき銅はくの重量と厚み測定 - 7/89
TM 2.2.13.1A	63	厚み、穴のメッキ処理、マイクロオーム法 - 1/83
TM 2.2.14	67	はんだ粉末粒度分布 - タイプ1-4向け選別法 - 1/95
TM 2.2.14.1	69	はんだ粉末粒度分布 - 測定顕微鏡法 - 1/95
TM 2.2.14.2	70	はんだ粉末粒度分布 - 光学画像解析法 - 1/95
TM 2.2.14.3	72	最大はんだ粉末粒度の測定 - 1/95
TM 2.2.15	74	ケーブル寸法 (フラットケーブル) - 6/79
TM 2.2.16	75	穴空きパネルを利用したアートワークマスタ評価 - 12/87
TM 2.2.16.1	76	オーバーレイによるアートワークマスタ評価 - 12/87
TM 2.2.17A	77	金属ファイルの表面あらさと形状 (接触スタイラス法) - 2/01
TM 2.2.18	79	機械測定によるラミネート厚の決定 - 12/94
TM 2.2.18.1	81	メタルクラッドラミネート厚の決定、断面 - 12/94
TM 2.2.19	82	孔パターン位置の測定 - 12/87

TM 2.2.19.1	83	ラミネートとプリプレグパネルの長さ、幅、直角度 - 12/94
TM 2.2.20	84	はんだペースト金属含有量、重量別 - 1/95
TM 2.2.21	86	高密度相互接続(HDI)/マイクロビア技術における誘電体の平面性 - 11/98
セクション 2.3 - 化学試験法		
TM 2.3.1	90	化学処理、適切な加工材 - 4/73
TM 2.3.1.1B	92	メタルクラッドラミネートの化学洗浄 - 5/86
TM 2.3.2G	93	フレキシブルプリント基板材の耐薬品性 - 12/07
TM 2.3.3A	96	絶縁材料の耐薬品性 - 2/78
TM 2.3.4B	97	耐薬品性、マーキング塗料とインキ - 8/87
TM 2.3.4.2A	98	溶剤曝露によるラミネート、プリプレグ、被覆フォイル製品の耐薬品性 - 12/94
TM 2.3.4.3	102	コア材料の塩化メチレンに対する耐薬品性 - 5/86
TM 2.3.6A	103	過硫酸アンモニウムによるエッチング法 - 7/75
TM 2.3.7A	104	エッチング、塩化第二鉄法 - 7/75
TM 2.3.7.1A	105	塩化第二銅によるエッチング法 - 12/94
TM 2.3.7.2A	107	アルカリエッチング法 - 12/94
TM 2.3.8A	109	引火性、フレキシブル絶縁材料 - 12/82
TM 2.3.8.1	112	フレキシブルプリント配線の引火性 - 12/88
TM 2.3.9D	113	プリプレグと薄積層の引火性 - 8/97
TM 2.3.10B	115	ラミネートの引火性 - 12/94
TM 2.3.10.1	118	プリント配線ラミネートのソルダマスクの引火性 - 8/98
TM 2.3.11	122	ガラス繊維構造 - 4/73
TM 2.3.13A	125	液体はんだ付け用フラックスの酸化測定- 電位差滴定と目視滴定法 - 6/04
TM 2.3.14	128	プリント、エッチング、プレート試験 - 4/73
TM 2.3.15D	130	銅はくまたはメッキの純度 - 5/04
TM 2.3.16B	132	プリプレグの樹脂含有量、焼失減量別 - 12/94
TM 2.3.16.1C	133	プリプレグの樹脂含有量、処理済重量別 - 12/94
TM 2.3.16.2	135	プリプレグの処理済重量 - 12/94
TM 2.3.17D	137	プリプレグの樹脂流動率 - 8/97
TM 2.3.17.2B	140	無流動プリプレグの樹脂流動 - 8/97
TM 2.3.18A	142	プリプレグ材料のゲル化時間 - 4/86
TM 2.3.19C	143	プリプレグの揮発性成分含有量 - 12/94
TM 2.3.21	146	ハルセル法のメッキ品質 - 8/97
TM 2.3.22	148	銅保護膜の塗布品質 - 2/78
TM 2.3.23B	150	加硫 (恒久性) 熱加硫ソルダマスク - 2/88
TM 2.3.23.1A	151	加硫 (恒久性) 紫外線主導ドライフィルムソルダマスク - 2/88
TM 2.3.24	153	金メッキの多孔性 - 2/78
TM 2.3.24.1	155	ニッケルめっき銅基板に電気めっきされた、金の有孔度試験 電子写真方式 - 10/85
TM 2.3.24.2A	158	銅合金とニッケルの金属被覆の多孔性(硝酸蒸気試験) - 8/97
TM 2.3.25D	160	溶媒抽出剤の固有抵抗による、イオン性表面汚染の検出と測定(ROSE) - 11/12
TM 2.3.25.1	165	ベア・プリント配線基板のイオン性洗浄度試験 - 10/00
TM 2.3.27	169	洗浄度試験 - 残留ロジン - 1/95
TM 2.3.27.1	174	ロジンフラックス残留分析-HPLC 法 - 1/95
TM 2.3.28B	177	回路基板のイオン分析 イオンクロマトグラフィー分析 - 11/12
TM 2.3.28.1	180	はんだ付け用フラックスとペーストのハロゲン化物含有量 - 6/04
TM 2.3.28.2	183	イオンクロマトグラフィーによるベア・プリント基板洗浄度の分析 - 12/09
TM 2.3.29	186	引火性 フレキシブルフラットケーブル - 11/88
TM 2.3.30A	188	無水フッ化炭素溶剤の溶剤 pH 測定 - 11/81
TM 2.3.31	189	UVキュアリング可能材のキュア度合い - 2/88 (確認済)
TM 2.3.32D	191	フラックス誘導による腐食 (銅鏡法) - 6/04
TM 2.3.33D	193	フラックスにおけるハロゲン化物の存在 クロム酸銀法 - 6/04
TM 2.3.34C	195	固形含有量 フラックス - 6/04

TM 2.3.34.1B	197	フラックス塗布またはフラックス入りはんだにおけるフラックス率 - 1/95
TM 2.3.35C	198	ハロゲン化合物含有量 定量 (塩化物と臭化物) - 6/04
TM 2.3.35.1A	200	スポットチェックによるフッ化物 フラックス - 定性 - 6/04
TM 2.3.35.2A	201	フッ化物濃度 フラックス - 定量 - 6/04
TM 2.3.36	204	塩素系溶剤の酸受入れ度 - 10/85
TM 2.3.37B	207	接着剤塗布誘導体膜の揮発性成分 - 5/98
TM 2.3.38C	210	表面有機不純物の検出試験 - 5/04
TM 2.3.39C	212	表面有機不純物の識別試験 (赤外線分析法) - 5/04
TM 2.3.40	215	熱安定性 - 7/95
TM 2.3.41	217	基材の総ハロゲン含有量向け検査法 - 4/06
TM 2.3.42	220	ソルダマスク - 溶剤と洗浄剤に対する抵抗 - 3/07

セクション 2.4 - メカニカル試験法

TM 2.4.1E	221	接着 テープ試験 - 5/04
TM 2.4.1.2	222	ハイブリッド基板における導体の接着 - 12/87
TM 2.4.1.3	224	接着 抵抗器 (ハイブリッド回路) - 12/87
TM 2.4.1.4	225	接着 重ね塗り (ハイブリッド回路) - 12/87
TM 2.4.1.5A	226	跡写りの測定 - 5/95
TM 2.4.1.6	228	接着 ポリマー塗膜 - 7/95
TM 2.4.2.1D	230	曲げ疲労と延性 フォイル - 3/91
TM 2.4.2A	233	銅はくの延性 - 3/76
TM 2.4.3E	234	曲げ疲労 フレキシブルプリント配線材料 - 6/11
TM 2.4.3.1C	235	曲げ疲労と延性 フレキシブルプリント配線 - 3/91
TM 2.4.3.2C	238	曲げ疲労と延性 フレキシブルメタルクラッド誘導体 - 3/91
TM 2.4.4B	241	ラミネートの曲げ強度 (周囲温度) - 12/94
TM 2.4.4.1A	243	ラミネートの曲げ強度 (高温) - 12/94
TM 2.4.5	245	耐折強度 フレキシブルプリント配線材料 - 4/73
TM 2.4.5.1	246	たわみ性 - コンフォーマルコーティング - 7/00
TM 2.4.6	247	熱油 - 4/73
TM 2.4.7A	248	機械加工性 プリント配線材料 - 7/75
TM 2.4.7.1	249	ソルダマスク - 機械加工性の測定 - 3/07
TM 2.4.8C	252	メタルクラッドラミネートの引きはがし強さ - 12/94
TM 2.4.8.1	254	引きはがし強さ 金属はく (薄積層向けキーホール法) - 1/86
TM 2.4.8.2A	257	高温時のメタルクラッドラミネートの引きはがし強さ (熱流体法) - 12/94
TM 2.4.8.3A	260	高温時のメタルクラッドラミネートの引きはがし強さ (熱空気法) - 12/94
TM 2.4.8.4	263	キャリア開放 薄銅 - 1/90
TM 2.4.9E	264	引きはがし強さ フレキシブル誘導体材料 - 6/14
TM 2.4.9.1	270	フレキシブル回路の引きはがし強さ - 11/98
TM 2.4.9.2	271	ボンディング行程 - 11/98
TM 2.4.11	273	フレキシブル誘導体材料のせん断強さ - 4/73
TM 2.4.12A	274	はんだ付け性 エッジディップ法 - 6/91
TM 2.4.13.1	277	ラミネートの熱応力 - 12/94
TM 2.4.13F	279	はんだフロート抵抗 フレキシブルプリント配線材料 - 5/98
TM 2.4.14	280	金属表面のはんだ性 - 4/73
TM 2.4.14.1	281	はんだ性 ウェーブソルダーリング法 - 3/79
TM 2.4.14.2A	284	液体フラックス活性 はんだぬれ性試験 - 6/04
TM 2.4.15A	287	表面仕上げ 金属はく - 3/76
TM 2.4.16B	288	起爆引き裂き強さ フレキシブル絶縁材料 - 3/14
TM 2.4.17	290	引き裂き強さ (伝搬) - 4/73
TM 2.4.17.1B	291	伝搬引き裂き強さ フレキシブル絶縁材料 - 2/13
TM 2.4.18B	293	引っぱり強度と伸び 銅はく - 8/80
TM 2.4.18.1A	295	引っぱり強度と伸び インハウスメッキ処理 - 5/04
TM 2.4.18.2	298	熱破裂強度 はく - 7/89
TM 2.4.18.3	300	引っぱり強度、伸び、引っぱり応力 - 7/95
TM 2.4.19C	303	引っぱり強度と伸び フレキシブルプリント配線材料 - 5/98

TM 2.4.20	305	端子ボンディング強度 フレキシブルプリント配線 - 4/73
TM 2.4.21E	306	ランドボンディング強度 無補強部品孔 - 5/04
TM 2.4.22C	308	胴曲がりとねじり (率) - 6/99
TM 2.4.22.1C	313	胴曲がりとねじり - ラミネート - 5/93
TM 2.4.22.2	315	基板曲率: 溶着誘導体を伴うシリコンウエハース - 7/95
TM 2.4.23	317	ラミネート材のソルダレジスト - 3/79
TM 2.4.24C	319	ガラス遷移温度と熱機械分析装置(TMA)によるZ軸の熱膨張 - 12/94
TM 2.4.24.1	322	熱剥離試験 (TMA 法) - 12/94
TM 2.4.24.2	324	有機膜のガラス遷移温度 - 動的機械分析(DMA)法 - 7/95
TM 2.4.24.3	326	有機膜のガラス遷移温度 - TMA 法 - 7/95
TM 2.4.24.4	328	高密度相互接続 (HDI) とマイクロビアに使用される材料のガラス遷移と引っぱり応力 - DMA 法 - 11/98
TM 2.4.24.5	333	高密度相互接続 (HDI) とマイクロビアに使用される材料のガラス遷移温度と熱膨張 - TMA 法 - 11/98
TM 2.4.24.6	338	熱分量分析(TGA)を利用したラミネート材の熱分解温度(Td) - 4/06
TM 2.4.25C	340	示差走査熱量測定(DSC)による、ガラス遷移温度と加硫要素 - 12/94
TM 2.4.26	343	アディティブプリント基板向けテープ試験 - 3/79
TM 2.4.27.1B	345	摩耗 (テープ式) ソルダマスクとコンフォーマルコーティング - 1/95
TM 2.4.27.2A	346	ソルダマスク摩耗 (鉛筆法) - 2/88 (確認済)
TM 2.4.28B	347	接着 ソルダマスク (非溶融金属) - 8/97
TM 2.4.28.1F	348	ソルダマスク接着 - テープ試験法 - 3/07
TM 2.4.29C	350	接着 ソルダマスク フレキシブル回路 - 3/07
TM 2.4.30	351	耐衝撃性 ポリマーフィルム - 10/86
TM 2.4.31A	352	折り フレキシブルフラットケーブル - 4/86
TM 2.4.32A	353	折り曲げ型温度試験 フレキシブルフラットケーブル - 4/86
TM 2.4.33C	354	曲げ疲労と延性 フラットケーブル - 3/91
TM 2.4.34	357	はんだペースト粘性 - Tバースピン スピンドル法(300,000?1,600,000センチポアズに適用) - 1/95
TM 2.4.34.1	359	はんだペースト粘性 - Tバースピン スピンドル法 (300,000 センチポアズ未満に適用) - 1/95
TM 2.4.34.2	361	はんだペースト粘性 - スパイラルポンプ法 (300,000?1,600,000 センチポアズに適用) - 1/95
TM 2.4.34.3	363	はんだペースト粘性 - スパイラルポンプ法 (300,000 センチポアズ未満に適用) - 1/95
TM 2.4.34.4	365	ペーストフラックス粘性 - Tバースピン スピンドル法 - 1/95
TM 2.4.35	366	はんだペースト - スランプ試験 - 1/95
TM 2.4.36C	369	リワークシミュレーション 有鉛部品向けスルーホール - 5/04
TM 2.4.37A	371	端子接続向け手付けはんだ工具の評価 - 7/91
TM 2.4.37.1A	373	プリント配線基板印加向け手付けはんだ工具の評価 - 7/91
TM 2.4.37.2	375	重度の熱負荷に対する手付けはんだ工具の評価 - 7/93
TM 2.4.38A	379	プリプレグスケールフロー試験 - 6/91
TM 2.4.39A	382	寸法安定性 ガラス強化薄積層 - 2/86
TM 2.4.40	385	多層プリント基板の内層ボンディング強度 - 10/87
TM 2.4.41	386	電氣的絶縁回路の線形熱膨張係数 - 3/86
TM 2.4.41.1A	389	石英ガラス(クオーツ)による熱膨張係数 膨張計法 - 8/97
TM 2.4.41.2A	392	熱膨張係数 - ストレインゲージ法 - 5/04
TM 2.4.41.3	396	面内熱膨張係数 有機膜 - 7/95
TM 2.4.41.4	398	体積熱膨張 無機基板のポリマー塗膜 - 7/95
TM 2.4.42	399	チップ接着剤のねじれ強さ - 2/88
TM 2.4.42.1	400	接着剤の高温機械強度保持 - 3/88
TM 2.4.42.2	401	ダイのせん断強度 - 2/98
TM 2.4.42.3	403	ワイヤボンディング引っぱり強度 - 2/98
TM 2.4.43	406	はんだペースト - はんだボール試験 - 1/95
TM 2.4.45	409	はんだペースト - はんだぬれ性試験 - 1/95
TM 2.4.46A	410	広がり試験 液体または抽出はんだ付け用フラックス はんだペーストと抽出心線または中間加工 - 6/04
TM 2.4.47	412	フラックス残渣乾燥度 - 1/95
TM 2.4.48	415	フラックス入りワイヤはんだのすり割り - 1/95

TM 2.4.49	417	はんだプール試験 - 1/95
TM 2.4.50	419	熱伝導度 ポリマーフィルム - 7/95
TM 2.4.51	420	自己シミング熱伝導接着剤 - 1/95
TM 2.4.52	421	基材向け樹脂系の破壊靱性 - 10/13
セクション 2.5 - 電氣的試験法		
TM 2.5.1B	429	プリント配線板材料のアーキ抵抗 - 5/86
TM 2.5.2A	431	絶縁材料のキャパシタンス - 7/75
TM 2.5.3B	432	ブレークダウン電流 めっきスルーホール - 8/97
TM 2.5.4	433	電流容量 多層プリント配線 - 4/73
TM 2.5.4.1A	436	導体の電流変化による導体温度上昇 - 8/97
TM 2.5.5A	437	プリント配線材料の誘電率 - 7/75
TM 2.5.5.1B	438	電極系に1MHz に接触する絶縁材料の誘電率と損失正接(損失係数) - 5/86
TM 2.5.5.2A	443	プリント配線基板材料の誘電率と損失係数--クリップ式 - 12/87
TM 2.5.5.3C	445	材料の誘電率と損失正接(損失係数) (二液電池式) - 12/87
TM 2.5.5.4	449	プリント配線基板材料の誘電率と損失係数--マイクロメータ法 - 10/85
TM 2.5.5.5C	451	Xバンドにおける誘電率と損失正接(損失係数)のストリップライン試験 - 3/98
TM 2.5.5.6	476	クラッドラミネートの誘電率向け非破壊全薄板共振試験 - 5/89
TM 2.5.5.5.1	488	14GHzに対する回路基板材料の複素比誘電率向けストリップライン試験 - 3/98
TM 2.5.5.7A	499	時間領域反射測定 (TDR) によるプリント基板上的特性インピーダンス - 3/04
TM 2.5.5.8	522	低周波誘電率と損失正接 ポリマーフィルム - 7/95
TM 2.5.5.9	527	誘電率と損失正接 平行板 1MHz-1.5 GHz - 11/98
TM 2.5.5.10	532	埋込型不動態材料の誘電率と損失正接を測定する高周波試験 - 7/05
TM 2.5.5.11	540	時間領域反射測定 (TDR) によるプリント基板上的伝搬遅延線 - 4/09
TM 2.5.5.13	556	スプリットシリンダ共振回路を利用した比誘電率と損失正接 - 1/07
TM 2.5.6B	560	硬質プリント配線材料の誘電破壊 - 5/86
TM 2.5.6.1B	563	ソルダマスク - 絶縁耐力 - 3/07
TM 2.5.6.2A	564	プリント配線材料の電気強度 - 3/98
TM 2.5.5.12A	567	プリント基板の信号損失量を測定する試験法 - 7/12
TM 2.5.6.3	591	誘電破壊電圧と絶縁耐力 - 10/86
TM 2.5.7D	594	誘電体耐圧 プリント基板 - 5/04
TM 2.5.7.1	596	誘電体耐圧 - ポリマーコンフォーマルコーティング - 7/00
TM 2.5.7.2A	598	誘電体耐圧 (高電位法) - プリント基板向け薄誘電層 - 11/09
TM 2.5.8A	601	フレキシブルプリント配線材料の損失係数 - 7/75
TM 2.5.10.1	602	接着剤相互接続ボンドの絶縁抵抗 - 11/98
TM 2.5.12	604	相互接続抵抗 多層プリント配線 - 4/73
TM 2.5.13A	605	銅はくの抵抗 - 3/76
TM 2.5.14A	606	銅はくの固有抵抗 - 8/76
TM 2.5.15A	609	フラットケーブルのRFI/EMIシールド用試験方法ガイドライン - 10/86
TM 2.5.16A	614	ショート 多層プリント配線の内部 - 11/88
TM 2.5.17E	615	プリント配線材料の体積抵抗率と表面抵抗率 - 5/98
TM 2.5.17.1A	617	誘電体材料の体積・表面抵抗率 - 12/94
TM 2.5.17.2	621	高密度相互接続 (HDI) とマイクロビアに使用される導体材料の体積抵抗率 2線式 - 11/98
TM 2.5.18B	624	特性インピーダンス フラットケーブル (不平衡) - 7/84
TM 2.5.19A	628	時間領域反射率計 (TDR) を使用したフラットケーブルの伝搬遅延 - 7/84
TM 2.5.19.1A	631	2重掃引オシロスコープを使用したフラットケーブルの伝搬遅延 - 7/84
TM 2.5.21A	635	デジタル不平衡クロストーク フラットケーブル - 3/84
TM 2.5.24	637	導体抵抗 フレキシブルフラットケーブル - 6/79
TM 2.5.25A	638	誘電体耐圧 フレキシブルフラットケーブル - 11/85
TM 2.5.26A	639	絶縁抵抗 フレキシブルフラットケーブル - 11/85
TM 2.5.27	640	プリント配線基板材料素板の表面絶縁抵抗 - 3/79
TM 2.5.28A	642	Q共振 フレキシブルプリント配線材料 - 4/88

TM 2.5.30	644	平衡および不平衡ケーブルの減衰測定 - 12/87
TM 2.5.31	648	電流漏れ (重ね塗りフィルムを介して) - 12/87
TM 2.5.32	649	抵抗試験 スルーホールめっき - 12/87
TM 2.5.33	651	手はんだ付ツールによる電氣的オーバーストレスの測定 - 11/98
TM 2.5.33.1	656	手はんだ付ツールによる電氣的オーバーストレスの測定 - 接地測定 - 11/98
TM 2.5.33.2	659	手はんだ付ツールによる電氣的オーバーストレスの測定 - 過度測定 - 11/98
TM 2.5.33.3	663	手はんだ付ツールによる電氣的オーバーストレスの測定 - 電流漏れ測定 - 11/98
TM 2.5.33.4	666	手はんだ付ツールによる電氣的オーバーストレスの測定 - 遮蔽エンクロージャ - 11/98
TM 2.5.34	669	内蔵型抵抗器向け負荷抵抗定格 - 7/12
セクション 2.6 - 環境試験法		
TM 2.6.1G	673	耐菌性 プリント配線材料 - 3/07
TM 2.6.1.1	676	耐菌性 コンフォーマルコーティング - 7/00
TM 2.6.2D	679	吸湿 フレキシブルプリント配線 - 2/12
TM 2.6.2.1A	681	吸湿 メタルクラッド プラスチックラミネート - 5/86
TM 2.6.3F	682	耐湿性・絶縁抵抗 プリント基板 - 5/04
TM 2.6.3.1E	686	ソルダマスク - 耐湿性・絶縁抵抗 - 3/07
TM 2.6.3.2B	691	耐湿性・絶縁抵抗 フレキシブルベース層誘導体 - 5/88
TM 2.6.3.3B	695	表面絶縁抵抗 フラックス - 6/04
TM 2.6.3.4A	699	耐湿性・絶縁抵抗 ? コンフォーマルコーティング - 7/03
TM 2.6.3.5	701	表面絶縁抵抗別ベア基板洗浄度 - 1/04
TM 2.6.3.6	705	表面絶縁抵抗 - フラックス - 遠隔通信 - 1/04
TM 2.6.3.7	708	表面絶縁抵抗 - 3/07
TM 2.6.4B	712	ガス放出 プリント基板 - 5/04
TM 2.6.5D	714	物理的衝撃 多層プリント配線 - 5/04
TM 2.6.6B	715	温度サイクル試験 プリント配線基板 - 12/87
TM 2.6.7A	716	熱衝撃と導通 プリント基板 - 8/97
TM 2.6.7.1A	718	熱衝撃 - コンフォーマルコーティング - 7/00
TM 2.6.7.2B	719	熱衝撃、導通、マイクロセクションング、プリント基板 - 5/04
TM 2.6.7.3	722	熱衝撃 - ソルダマスク - 7/00
TM 2.6.8E	724	熱応力 メッキスルーホール - 5/04
TM 2.6.8.1	725	熱応力 ラミネート - 9/91
TM 2.6.9B	727	振動 硬化プリント配線 - 5/04
TM 2.6.9.1	728	超音波エネルギーに対する電子組み立ての感度測定試験 - 1/95
TM 2.6.9.2	733	超音波エネルギーに対する電子部品の感度測定試験 - 1/95
TM 2.6.10A	737	X線(放射線写真) 多層プリント配線基板試験法 - 8/97
TM 2.6.11B	739	加水分解安定性 ソルダマスクあるいはコンフォーマルコーティング - 8/98
TM 2.6.11D	740	ソルダマスク - 加水分解安定性 - 3/07
TM 2.6.11.1	741	加水分解安定性 - コンフォーマルコーティング - 7/00
TM 2.6.12	743	温度試験 フレキシブルフラットケーブル - 6/79
TM 2.6.13	744	金属 dendrite 成長に対する感受性評価: コーティングを施さないプリント配線 - 10/85
TM 2.6.14D	746	ソルダマスク - 電気化学的移動に対する抵抗 - 3/07
TM 2.6.15C	750	腐食 フラックス - 6/04
TM 2.6.14.1	753	電気化学的移動に対する抵抗試験 - 9/00
TM 2.6.16	756	ガラスエポキシ ラミネート整合性向け圧力容器法 - 7/85
TM 2.6.16.1	759	高温および圧力下(圧力容器)における高密度相互接続 (HDI) 材料の耐湿性 - 8/98
TM 2.6.17	761	加水分解安定性 フレキシブルプリント配線材料 - 12/82
TM 2.6.18A	762	低温フレキシブル フレキシブルプリント配線材料 - 7/85
TM 2.6.19	763	ハイブリッドセラミック 多層基板ボードの環境試験および絶縁抵抗試験 - 12/87
TM 2.6.21B	767	メタルクラッド フレキシブルラミネート、カバー材料、接着剤ボンディングフィルムの使用温度 - 6/11

TM 2.6.23	772	蒸気エージェー温度再現性向け試験手順 - 7/93
TM 2.6.24	775	環境条件下における接合部安定性 - 11/98
TM 2.6.25A	778	CAF(Conductive Anodic Filament) 抵抗試験: X-Y 軸 - 5/12
TM 2.6.26A	789	直流電流誘導 温度サイクリング試験 - 6/14
TM 2.6.27	799	熱応力 対流式リフロー 組立シミュレーション - 5/09
TM 2.6.28	807	水分および吸湿度 (バルク) プリント基板 - 8/10

セクション 3.0 - コネクタ試験法

TM 3.1A	809	Contact Resistance, Connectors
TM 3.2A	811	Contact Retention, Connectors
TM 3.3A	812	Crimp Tensile Strength, Connectors
TM 3.4B	813	Durability, Connectors
TM 3.5A	815	Humidity, Connectors
TM 3.6A	818	Insulation Resistance, Connectors
TM 3.7A	819	Low Level Circuit Connectors
TM 3.8A	821	Mechanical Shock, Connectors
TM 3.9A	826	Salt Spray, Connectors
TM 3.10A	828	Solderability, Connectors
TM 3.11A	830	Thermal Shock, Connectors
TM 3.12A	832	Vibration, Connectors
TM 3.13A	838	Withstanding Voltage, Connectors
TM 3.14A	840	High Temperature Life, Connectors
TM 3.15	842	Fungus Resistance, Connectors
TM 3.16	843	Fretting Corrosion, Connectors
TM 3.17	845	Industrial Gas Test (Battelle Method), Connectors
TM 3.18	846	Mating and Unmating Force, Connectors

※ 各検査方法のタイトル横にある、数字/数字は、メソッドの開発年度を示す。

例: 8/10⇒2010年8月 11/98⇒1998年11月 9/00⇒2000年9月

※ 本目次の「ページ番号項」は、本文の左下数字を示している。右下にあるPage ofは題目内のページ数である